

Technical Data Sheet 中低温固化 环氧灌封胶

SE610 是一款无溶剂型单组分环氧灌封胶，可在中低温条件下快速固化，兼具高粘接强度与优异韧性，绝缘性能突出，耐高低温冲击能力良好，适配电子电器类低温固化应用场景。

主要用途

- 无刷电机马达引线固定、LED 背光灯珠、电子元器件、家用手持电器等粘接与灌封；
- 适用于工业电子电器领域中无法承受高温固化、需 100℃ 以内完成固化的场景。

产品特性

- 支持中低温固化，工艺灵活性强；
- 韧性优异，绝缘与粘接性能俱佳；
- 耐高低温冲击性能出色。

技术参数

性能	标准	指标
颜色	目测	黑色
外观	目测	半流淌
粘度 Pa·s	GB/T 2794-1995	30±10
密度 g/cm ³	GB/T 13354-1992	1.3±0.1
固化条件 °C/H	GB/T 10247-2008	95°C/1H

硬度 Shore D	GB/T 2411-1980	90
玻璃化转变温度 Tg °C	ASTM E1545	75
拉伸剪切强度 (钢 - 钢) MPa	GB/T 7124-1986	18
拉伸剪切强度 (铝 - 铝) MPa	GB/T 7124-1986	13
冲击剪切强度 (铝 - 铝) MPa	GB/T 7124-1986	11
线性膨胀系数 CTE 10 ⁻⁶ /K	GB/T 1036-1989	45 (< Tg) ; 110 (> Tg)
体积电阻率 Ω·cm	GB/T 1692-92	5.8×10 ¹⁴
介电强度 kV/mm	GB 1408.1-1999	≥17
使用温度范围 °C	--	-40~120
保质期 (-10°C低温密封)	--	6 个月

以上数据为 80°C 固化 30min 后的标态检测数据。

使用说明

1. 产品需低温储存，使用前需在室温条件下回温，回温前请勿打开包装；未用完的产品应及时密封，放回低温环境保存。
2. 需彻底清洁基材表面，去除油污、灰尘、氧化层及其他污染物，保证粘接面洁净干燥。
3. 粘接完成后，工件应在 0.1-0.5kg/cm² 的压力下进行固化，推荐固化条件为 95°C 保温 1 小时。
4. 若粘接基材不同、固化条件调整，或存在其他超出指标范围的情况，建议先开展验证实验，或联系技术人员确认适配方案。

储存须知

- -10℃密封储存，贮存期 3 个月；
- -5℃至 0℃密封储存，贮存期 1 个月。

包装及运输

包装规格

50ml / 支，1kg / 桶，5kg / 桶。

运输要求

产品属于非危险品，可按一般化学品（低温存储类）运输，运输过程中需维持低温条件，避免高温暴晒。

安全注意事项

禁食，远离儿童存放。

本品固化前应避免与眼睛、皮肤接触。如不慎接触皮肤，先用肥皂水或酒精擦洗，再用清水冲洗；如不慎接触眼睛，先用大量清水冲洗，必要时立即就医。

产品安全资料可从 SEPNA 及各分销商处获得，也可通过邮件或服务电话咨询获取。

特别说明

本资料表中的产品性能与使用信息均为标准条件下测得。由于使用条件存在差异，使用者有责任根据自身应用场景对产品进行测试验证。除非 SEPNA 出具针对特定需求的书面证明，否则 SEPNA 仅保证产品符合销售说明书所列规范，不担保其他特定用途。若产品未达到所列要求，SEPNA 的唯一责任为退款或换货，不承担任何意外事故与间接损失责任。

VERSION 1.0/ 2025-03

SERVICE HOTLINE:400-882-1323

E-MAIL:sepna@sepna.cc

WWW.SEPNA.CC